

证券代码：301348

证券简称：蓝箭电子

公告编号：2024-003

## 佛山市蓝箭电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要



## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

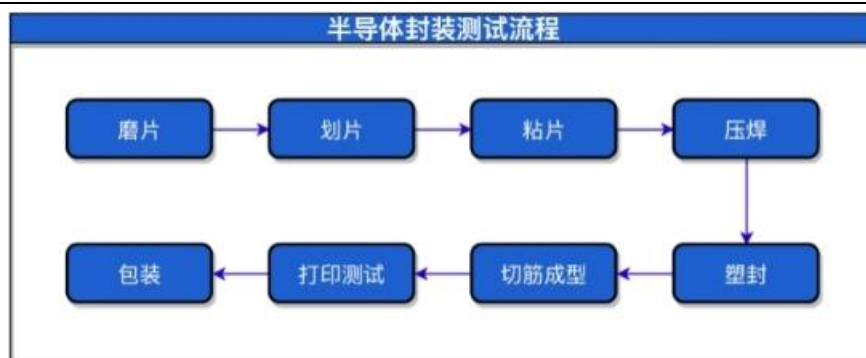
股票简称	蓝箭电子	股票代码	301348
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张国光	林品旺	
办公地址	中国广东省佛山市禅城区古新路 45 号	中国广东省佛山市禅城区古新路 45 号	
传真	0757-63313400	0757-63313400	
电话	0757-63313388	0757-63313388	
电子信箱	zhangguoguang@fsbrec.com	linpinwang@fsbrec.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### 2.1、报告期内公司所处行业情况

##### （1）封装测试行业发展情况

封装环节是半导体封装和测试过程的主要环节。其功能主要包括两方面：首要功能是电学互联，通过金属 Pin 赋予芯片电学互联特性，便于后续连接到 PCB 板上实现系统电路功能；另一功能是芯片保护，主要是对脆弱的裸片进行热扩散保护以及机械、电磁静电保护等。



公司目前主要掌握的封测技术包括通孔插装技术、贴片式封装技术、倒装焊封装技术及系统级封装技术，主要涉及的封装形式包括 TO、SOT/TSOT、SOD、SOP、DFN/QFN 等。

### (2) 全球半导体市场发展情况

2023 年，受贸易摩擦和科技竞争加剧了全球半导体产业的紧张局势，导致市场的不确定性增加。其次，消费电子终端市场需求疲软，半导体产业发展受到一定制约。此外，通货膨胀率和局部战事的持续也给半导体产业带来了不小的影响。但是在长期发展中，随着全球经济回暖，半导体产业仍然具有广阔的市场前景和增长潜力。随着数字化转型的深入推进，人工智能、物联网等新兴领域对高性能芯片的需求不断增加，同时 5G、自动驾驶、智能家居等应用场景也在不断拓展新的市场空间。

根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2023 年的全球半导体市场规模预计会出现一些变化。首先，WSTS 调高了对于 2023 年全球半导体营收的预期，预计今年全球半导体营收将达到 5201 亿美元，年降幅为 9.4%。日前，多家行业协会和市场分析机构作出 2024 年全球半导体市场回暖的积极判断，美国半导体行业协会（SIA）预测称，2024 年全球半导体产业销售额将增长 13.1%。

Fall 2023	Amounts in US\$M			Year on Year Growth in%		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Americas	141,136	132,536	162,154	16.2	-6.1	22.3
Europe	53,853	57,048	59,480	12.8	5.9	4.3
Japan	48,158	47,209	49,275	10.2	-2.0	4.4
Asia-Pacific	330,937	283,333	317,455	-3.5	-14.4	12.0
<b>Total World-SM</b>	<b>574,084</b>	<b>520,126</b>	<b>588,364</b>	<b>3.3</b>	<b>-9.4</b>	<b>13.1</b>
Discrete-Semiconductors	33,993	35,951	37,459	12.0	5.8	4.2
Optoelectronics	43,908	42,583	43,324	1.2	-3.0	1.7
Sensors	21,782	19,417	20,127	13.7	-10.9	3.7
Integrated-Circuits	474,402	422,174	487,454	2.5	-11.0	15.5
Analog	88,983	81,051	84,056	20.1	-8.9	3.7
Micro	79,073	76,579	81,937	-1.4	-3.2	7.0
Logic	176,578	174,944	191,693	14.0	-0.9	9.6
Memory	129,767	89,601	129,768	-15.6	-31.0	44.8
<b>Total Products-SM</b>	<b>574,084</b>	<b>520,126</b>	<b>588,364</b>	<b>3.3</b>	<b>-9.4</b>	<b>13.1</b>

数据来源：WSTS

### (3) 我国集成电路产业发展情况

消费电子终端市场需求疲软，我国集成电路产业规模发展受到一定制约。根据国家统计局的数据显示，2023 年中国的集成电路产量为 3514 亿块，相较 2022 年的 3242 亿块有所增长。根据中国海关总署官网数据显示，2023 年中国累计进口集成电路 4795 亿颗，较 2022 年下降 10.8%；进口金额 3494 亿美元，同比下降 15.4%。此外，2023 年中国二极管和类似半导体组件进口量也下降 23.8%。中国集成电路和半导体设备进口疲软，反映 2023 年全球经济逆风，特别是中国智能手机和笔记本电脑销售疲软等因素影响。同时，随着我国集成电路产品国产替代进程的逐渐加快，中国企业也在努力提高本土芯片产量，以减少对进口芯片的依赖。

根据《2021-2025 年中国半导体封测行业市场现状与发展前景报告》，预计中国半导体封测市场规模将从 2021 年的约 3,467 亿元增长至 2025 年的约 5,189 亿元，年复合增长率约为 7%。在增速方面，随着国内半导体产业的快速发展及全球产能转移趋势的持续，中国半导体封测市场将继续保持较高的增长速度。

## 2.2、报告期内公司从事的主要业务

### （一）公司主营业务

公司从事半导体封装测试业务，为半导体行业及下游领域提供分立器件和集成电路产品。产品类型主要为二极管、三极管、场效应管、可控硅、IGBT、SiC SBD、SiC MOS 等分立器件产品和 LDO、AC-DC、DC-DC、锂电保护充电管理 IC 及 LED 驱动 IC 等集成电路产品。

封装测试行业的创新主要体现为产品工艺上的创新，技术水平主要体现为产品生产的工艺水平。公司注重封装测试技术的研发升级，通过工艺改进和技术升级构筑市场竞争优势，掌握金属基板封装、全集成锂电保护 IC、功率器件封装、超薄芯片封装、半导体/IC 测试、高可靠焊接、高密度框架封装、系统级封装（SIP）等一系列核心技术，在封装测试领域具有较强的竞争优势。

公司已通过自主创新在封测全流程实现智能化、自动化生产体系的构建，具备 12 英寸晶圆全流程封测能力，在功率半导体、芯片级贴片封装、第三代半导体等领域实现了科技成果与产业的深度融合。公司已形成年产超 150 亿只半导体的生产规模，分立器件生产能力全国企业排名第八，位列内资企业第四，是华南地区重要的半导体封测企业。

公司作为国家级高新技术企业，自成立以来坚持以技术创新为核心，凭借多年丰富的行业经验积累以及自主研发能力，秉承“以客户需求为中心”的服务理念，获得行业内客户的广泛认可。经过多年发展与积累，公司客户遍布华南、华东、西北、西南等多个区域，产品广泛应用于家用电器、电源、电声等诸多领域，多年来公司与客户建立了长期稳定的合作关系。

公司持续加大对半导体封测技术的研发及创新投入，建立了半导体器件工程技术研究开发中心，并获得了广东省省级企业技术中心认定。公司拥有国内外先进的检测、分析、试验设备，利用统计过程控制（SPC）等工具实现严格的过程控制，拥有较为完善的设备试生产、验收流程，推行全员生产维护（TPM）管理模式和专业、专职的产品经理团队。

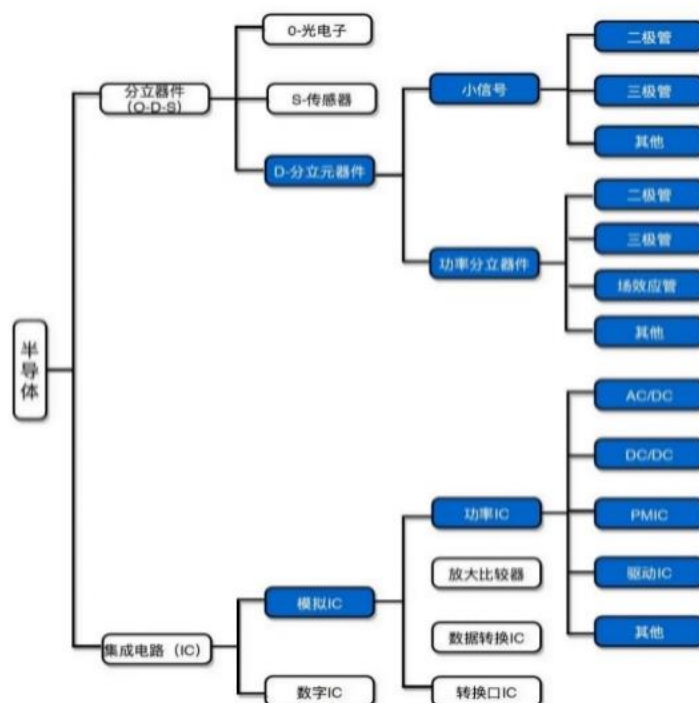
公司荣获高新技术企业、国家知识产权优势企业等资质及荣誉。公司多次荣获广东省科学技术奖、佛山市科学技术奖等省、市科技奖项。

目前，公司已通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、IATF16949 汽车行业质量管理体系标准认证、知识产权管理体系认证及职业健康管理体系认证。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

## （二）公司的主要产品和服务

公司主要为半导体行业及下游领域提供分立器件和集成电路产品，产品类型主要为二极管、三极管、场效应管、可控硅、IGBT、SiC SBD、SiC MOS 等分立器件产品和 LDO、AC-DC、DC-DC、锂电保护充电管理 IC 及 LED 驱动 IC 等集成电路产品。公司主营业务产品如下：


















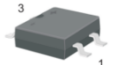












注：图中标蓝的产品为公司主营业务产品。

### 1、分立器件产品

公司分立器件产品涉及 40 多个封装系列。按照功率划分，公司分立器件产品包括功率二极管、功率三极管、功率 MOS 等功率器件和小信号二极管、小信号三极管等小信号器件产品；按照具体产品类别

划分，公司分立器件产品包括高反压三极管、肖特基二极管、ESD 保护二极管、屏蔽栅型 MOSFET、超结型 MOSFET 等产品；按照封装类型划分，公司分立器件产品主要封装形式包括 TO、SOT、SOP、DFN、PDFN 等。具体产品情况如下：

产品类别	产品名称	具体类别	主要功能	应用领域	具体应用	技术优势	封装形式			
分立器件	三极管	音频三极管	信号放大、信号开关、功率放大器等	消费类电子	电源、显示器、电话机、顶盒等	封装产品规格齐全，功率器件采用创新结构设计。在产品设计上具有客户配套服务优势				
		普通三极管					TO-220F	TO-220	DFN1006-3L	SOT-323/363
		数字三极管								
		高反压三极管					TO-252	SOT-89	SOT-23	TO-3P
	二极管	肖特基二极管	电源整流、电流控制、稳压、开关等	消费类电子、网络通信、安防、汽车电子等	电源、家电、数码产品等	采用沟槽技术，采用铜桥封装工艺，产品具有优异的性能指标及电学参数				
		ESD/TVS					SMAF/SMBF	TO-252	DFN1006-2L	DFN0603
		稳压二极管								
		快恢复二极管					SOD-323	SOD-123FL	SMA/B/C	TO-277
		整流桥								
	MBF	MBS	ABF	ABS						
	场效应管	平面型 MOSFET	信号放大、负载开关、功率控制等	消费类电子、安防、网络通信、汽车电子等	充电器、电池保护、马达驱动、负载开关等	采用有平面、沟槽和超结芯片工艺产品，采用铜桥封装工艺，产品具有优异的性能参数				
		沟槽型 MOSFET					PDFN3×3	TO-252	SOP-8	SOT23-3/6
		屏蔽栅型 MOSFET								
		超结型 MOSFET					PDFN5×6	DFN2×2	DFN8×8-3L	DFN1006-3L

## 2、集成电路产品

在集成电路领域，公司主要产品包括 SOT、SOP、DFN、QFN 等封装涉及 30 多个系列，按照产品类别划分，主要产品包括 LDO、AC-DC、DC-DC、锂电保护 IC 及 LED 驱动 IC 等。具体产品情况如下：

产品类别	产品名称	具体类别	主要功能	应用领域	具体应用	技术优势	封装形式			
集成电路	电源管理	LED 驱动 IC	通过交流转换成直流，提供给 LED 器件稳定可控的恒定电流，同时保证有较好的抗干扰能力	广泛应用于照明、汽车电子等	日光灯、球泡灯、筒灯、射灯、面板灯、汽车转向灯、路灯等	为优化芯片功能的自主设计框架，多芯片互联焊接技术，高密度焊线技术，多站点高效率 IC 的精准测试技术，高可靠性的封装技术				
							SOP-7/8	ESOP-8	SOT23-3/5/6	SOT89-3/5
										
							TO-252			
		DC-DC	直流电压转换器，为线路提供稳定电压，起到噪声隔离、安全隔离等	广泛应用于消费电子、汽车电子等	调制解调器、通信设备（平板电脑、数码相机等）	封装产品规格齐全，在粘片、压焊积累了深厚的技术沉淀，采用倒装技术，提供高功率密度、高可靠性的产品				
							SOT23-5/6	DFN3×3-6/8/10L	SOP-8	TSOT23-5/6
										
							DFN2×2-6/8L	DFN3×2-8L	DFN1.6×1.2-8L	



产品类别	产品名称	具体类别	主要功能	应用领域	具体应用	技术优势	封装形式			
		锂电保护 IC	为锂离子电池（可充电）提供过充、过放、过流及短路保护，使其安全可靠为其他电子设备提供稳定的供电电压	广泛应用于汽车电子、消费电子、网络通信等	笔记本电脑、平板电脑、手机、数码相机、无人机等	采用高度集成的芯片集成技术，将保护 IC 和 MOS 及外围电阻、电容等几个不同的器件，通过芯片工艺技术集成为一个芯片，为客户贴片组装降低成本，采用片式超小型封装				
							DFN1010--4L	DFN2x2-6/8L	DFN3x3-6/8/10L	ESOP-8
										
							SOT23-3/5/6			
		稳压 IC	具有过流保护、过温保护、精密基准源、差分放大器、延迟器等	消费类电子、网络通信、安防等	数码产品、TV、家电、电脑等	具有负载短路保护、过压关断、过热关断、反接保护等功能，低输出噪声、低静态电流及低于 100mV 的压差				
							SOT-223	SOT23-3/5	SOT89-3L	TO-252
		AC-DC	交流转换成直流	消费类电子、安防、网络通信等	开关电源、充电器、适配器、电源控制板等	采用集成封装，内置高压功率开关器件，具备输出过压保护功能，欠压锁定保护功能，过温保护功能				
							SOP-7/8	HTSSOP16	QFN3x3-16/20L	QFN4x4-16/24/32L
		多通道阵列 TVS	为电子产品及通信系统提供防护静电及抗浪涌电流能力	消费类电子、安防、网络通信、汽车电子等	高清多媒体接口、触摸屏等电子设备端口处，通信设备端口及基站等	通过新设计的高密度框架使单位成本下降 15%，塑封生产效率提升 50%，去氧化和成型分离生产效率提升 100%，低电容、低钳位电压，为国内知名厂家配套服务				
							SOT23-6		SOP-8	

## 3、主要会计数据和财务指标

## (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑是 ☐否

追溯调整或重述原因

其他原因

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年 末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	1,917,266,563.60	1,121,237,686.95	1,121,237,686.95	71.00%	1,132,801,776.25	1,132,801,776.25
归属于上市公司股东的净资产	1,567,590,701.60	725,216,318.31	725,216,318.31	116.15%	653,791,669.26	653,791,669.26
	2023 年	2022 年		本年比上年增 减	2021 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	736,580,879.68	751,633,605.95	751,633,605.95	-2.00%	735,874,115.27	735,874,115.27
归属于上市公司股东的净利润	58,368,765.24	71,424,649.05	71,424,649.05	-18.28%	77,270,578.16	77,270,578.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,395,530.89	65,400,473.81	69,168,448.44	-38.71%	72,090,430.44	76,275,306.36
经营活动产生的现金流量净额	92,607,221.44	95,995,329.83	95,995,329.83	-3.53%	47,637,844.31	47,637,844.31
基本每股收益(元/股)	0.35	0.48	0.48	-27.08%	0.52	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.48	0.48	-27.08%	0.52	0.52
加权平均净资产收益率	5.75%	9.85%	9.85%	-4.10%	11.70%	11.70%

## (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	174,770,168.39	198,068,675.74	156,761,694.48	206,980,341.07
归属于上市公司股东的净利润	15,762,853.00	24,687,165.03	8,322,496.36	9,596,250.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,546,695.85	22,094,986.00	6,875,707.35	-121,858.31
经营活动产生的现金流量净额	72,542,283.60	36,825,597.55	-23,571,669.67	6,811,009.96

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

#### 4、股本及股东情况

##### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,985	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,408	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
王成名	境内自然人	15.83%	31,669,430.00	31,669,430.00	不适用	0.00			
陈湛伦	境内自然人	9.86%	19,716,218.00	19,716,218.00	不适用	0.00			
深圳市银圣宇创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.76%	19,519,430.00	19,519,430.00	不适用	0.00			
张顺	境内自然人	7.55%	15,107,565.00	15,107,565.00	不适用	0.00			
舒程	境内自然人	4.38%	8,751,502.00	8,751,502.00	不适用	0.00			
广东比邻投资基金管理有限公司—比邻创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	4.04%	8,082,902.00	8,082,902.00	不适用	0.00			
深圳前海蓝芯咨询管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.25%	2,500,000.00	2,500,000.00	不适用	0.00			
深圳前海箭入佳境咨询管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.25%	2,500,000.00	2,500,000.00	不适用	0.00			
赵秀珍	境内自然人	0.98%	1,958,549.00	1,958,549.00	不适用	0.00			
范小宁	境内自然人	0.95%	1,890,155.00	1,890,155.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	王成名、陈湛伦、张顺为一致行动人。								

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

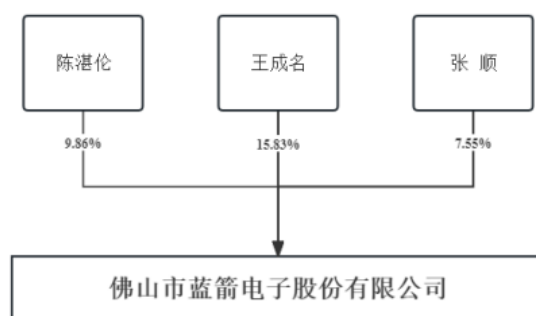
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

##### (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

## 三、重要事项

经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市蓝箭电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1048号）同意，佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）5,000.00万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为18.08元/股，募集资金总额为人民币904,000,000.00元，扣除相关发行费用（不含税）人民币119,994,381.95元后，募集资金净额为人民币784,005,618.05元。

经深圳证券交易所《关于佛山市蓝箭电子股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上〔2023〕721号）》审核，公司获准在深交所创业板上市。公司证券简称“蓝箭电子”，股票代码“301348”，正式上市交易日为2023年8月10日，上市后公司总股份数为200,000,000股。